

Modulares Rework System mit HCT-1000 und Vorheizer PCT-1000 bis 450 °C - Oki MRS-1100A

Artikel-Nr. WL26957

Hersteller Oki

Komplettes Konvektions-Rework-System zum Auslöten und Reflow von BGA-, CSP- und SMT-Bauteilen. Das programmierbare Handstück HCT-1000 arbeitet mit 600 W bis 450 °C bei 5-25 l/min, der Vorheizer PCT-1000 bringt die Leiterplatte mit 1200 W auf 25 bis 350 °C. Bis zu 50 Profile lassen sich speichern, wahlweise mit fester Temperatur oder Vierzonen-Programmierung.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Leistung	600 W
Temperatur (max.)	bis 450 °C
Temperaturbereich	100-450 °C



BESCHREIBUNG

Beim Tausch von BGA und CSP auf mehrlagigen Leiterplatten muss die Baugruppe vorgewärmt und das Bauteil profilgesteuert erwärmt werden, sonst drohen Delamination und kalte Lötstellen. Das Oki MRS-1100A verbindet dazu das programmierbare Konvektionswerkzeug HCT-1000 mit dem Vorheizer PCT-1000 zu einem integrierten Rework-System.

VORTEILE

- Integriertes Konvektions-Rework-System zum Entfernen und Reflow von BGA-, CSP- und SMT-Bauteilen
- Programmierbar mit Digitalanzeige und Programmspeicher für bis zu 50 Profile
- Wahlweise Profilerstellung mit fester Temperatur oder Vierzonen-Programmierungsoption
- Temperaturregelung über die Heizleistung intern oder direkt an der Platine extern
- Verschiedene Platinenhalter und Zubehör für unterschiedliche Leiterplattengrößen

ANWENDUNGEN

Bauteiltausch und Reparatur an bestückten Leiterplatten in Elektronikfertigung, Service, Labor und Fehleranalyse. Geeignet für BGA, CSP und übliche SMT-Gehäuse, auch auf thermisch anspruchsvollen Multilayer-Baugruppen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Zum Lieferumfang gehören das Konvektionswerkzeug HCT-1000, der Vorheizer PCT-1000, der verstellbare Werkzeughalter ATH-1100A und die Platinenhalterung BH-2000. Die Heißluftdüsen der Serie HN-B für das HCT-1000 werden passend zur Bauteilgröße separat gewählt, weitere Platinenhalter sind als Zubehör erhältlich.